

Xceed

New Generation 3D AOI



3D基板外觀檢查裝置

PARMI
Pattern Recognition &
Machine Intelligence

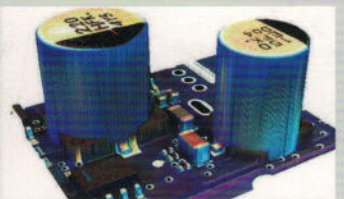
Xceed

New Generation 3D AOI

高精度 & 高速検査

新型 3D AOIセンサーヘッド (TRSC-I)

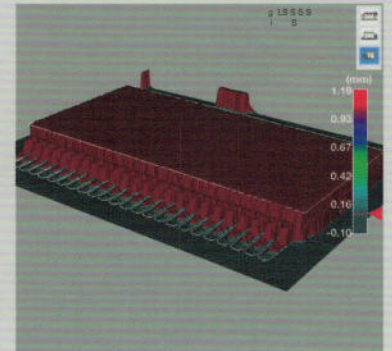
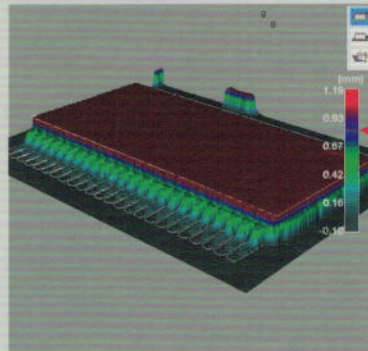
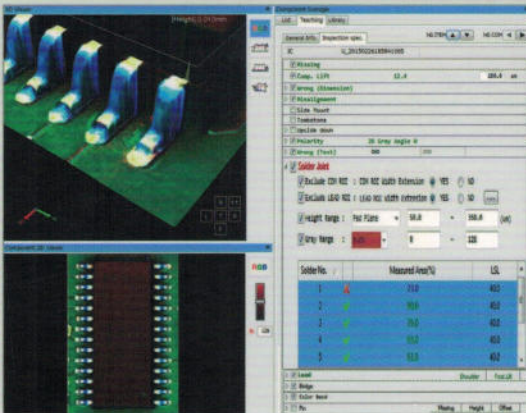
- ・デュアルレーザー技術と4メガピクセルの高速CMOSカメラを一体化
- ・RGB LED 照明
- ・テレセントリック光学系
- ・コンパクトなデザインによる超軽量センサーヘッド
- ・ヘッドスピード及び分解能 : 65cm²/秒 @ 14 x 14 μ m
- ・検査時間 : PCB 260mm(L) x 200mm(W)において
10sec以内 (搬入、搬出時間含む)



影を小さくする事により、背高部品間の小型部品も検査が可能です。

3D AOI

3次元の測定データより正確な検査が可能です。

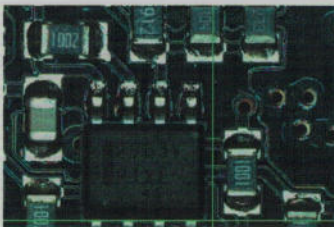


部品形状の抽出、はんだジョイント部の抽出が可能です。

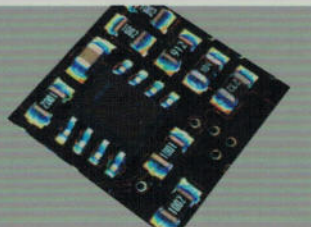


優れた検査

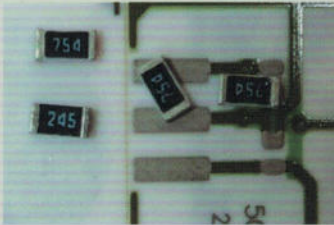
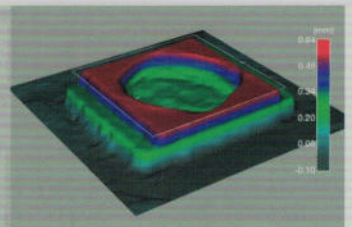
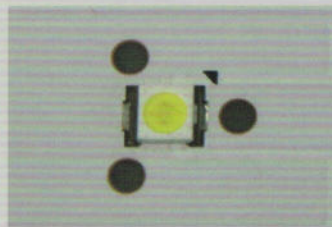
基板/部品の「材質」「表面状況」「色」に影響を受けません



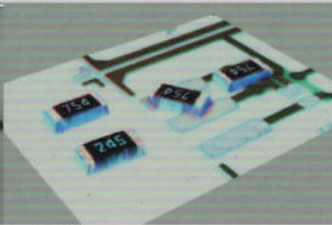
暗い基板



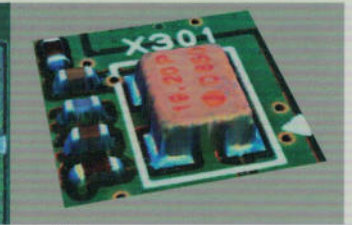
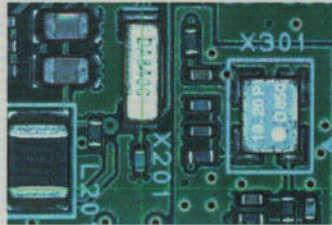
白い基板



セラミック基板

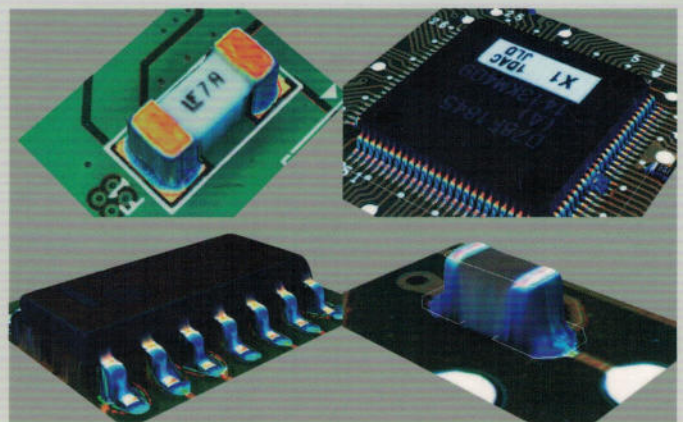
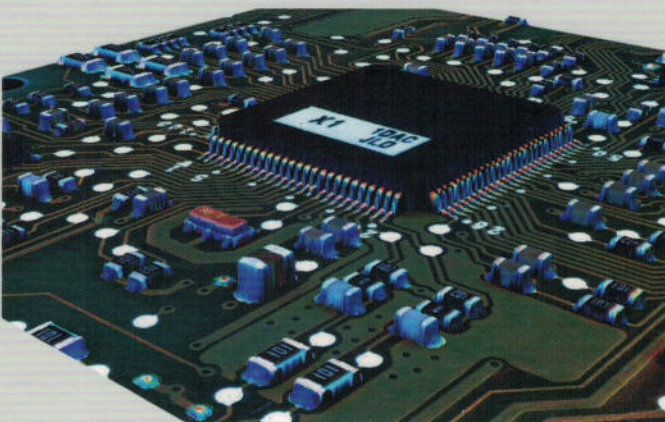


反射しやすい部品



優れた3Dイメージ

高度な信号処理技術により、ノイズのない優れた3Dイメージを表示します。





Compact Design

850mm

簡単なオペレーション

SPIフレンドリーUI

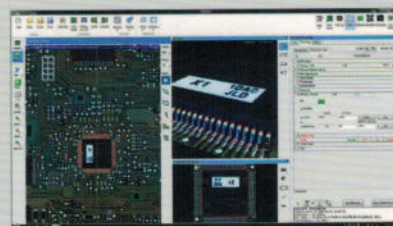
ソフトウェアの基本UIは定評のあるSPI検査装置とほぼ同等。既存ユーザーはもちろん、初めての方でも簡単に操作が出来ます。

AOIUI



検査画面

SPIUI

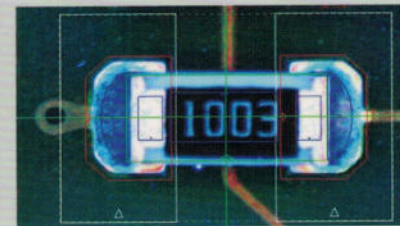
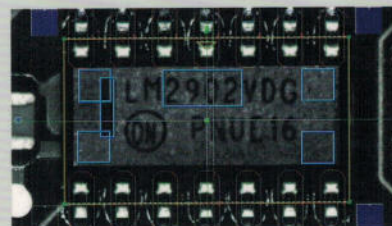


ティーチング画面

簡単なティーチング

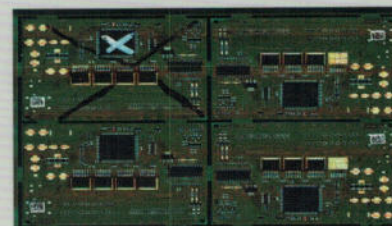
部品種類によっては、ワン・クリック・ティーチングが可能であり、自動的に検査に必要な基本ROIが作成され、デバック作業せずに、7つの検査項目が出来ます。

・基本検査(未実装、部品浮き、部品サイズ、位置ずれ、部品立ち、マンハッタン、表裏逆実装)



バーコード&バッドマーク認識

バーコードとバッドマーク認識と検査を同時に行う事により、生産効率向上させます。(1D、2D、QRレーザーマーキング及びプリントバーコード認識可能です。)



あらゆる不良を検出

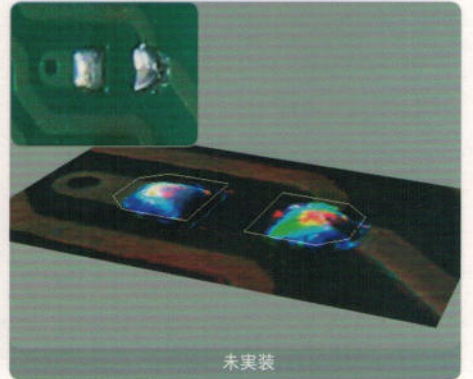
2D AOIでは検出が難しい部品でも、高さ測定を行い、直観的に分かりやすいように、リード浮き、部品浮き等の検出結果を最適化表示します。また、部品サイズ、未実装、位置ずれ、部品立ち(マンハッタン)、表裏逆実装、極性間違い、はんだ不良(コールドジョイント)、リード欠落、リード変形、ブリッジ、文字検査(OCR、OCV)、カラーバンド、ピン等の、ありとあらゆる不良の検出が出来ます。



リード浮き



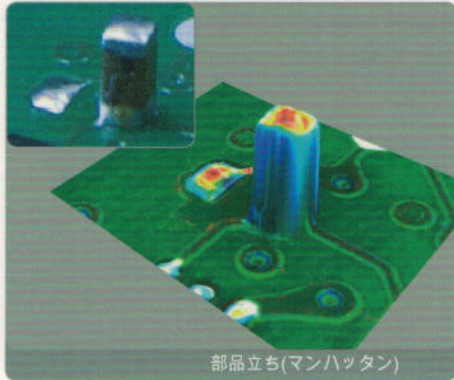
部品浮き



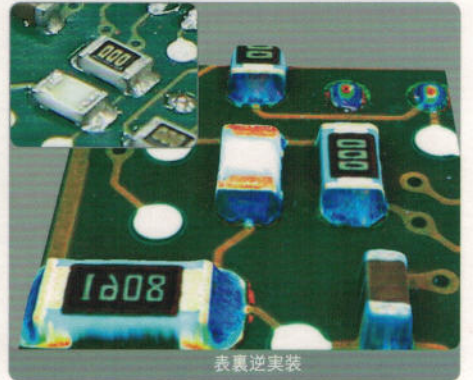
未実装



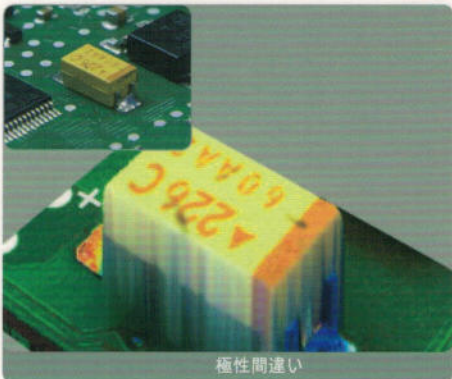
位置ずれ



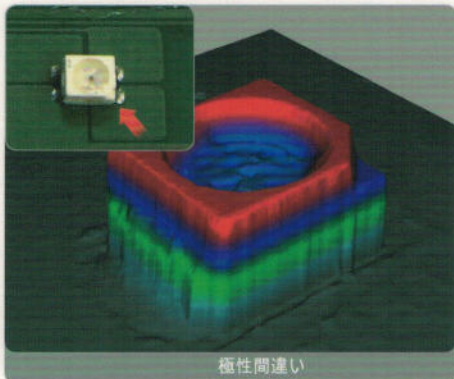
部品立ち(マンハッタン)



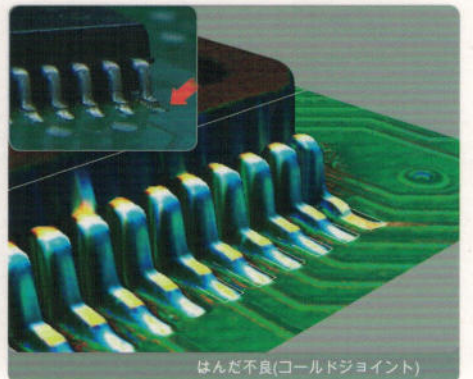
表裏逆実装



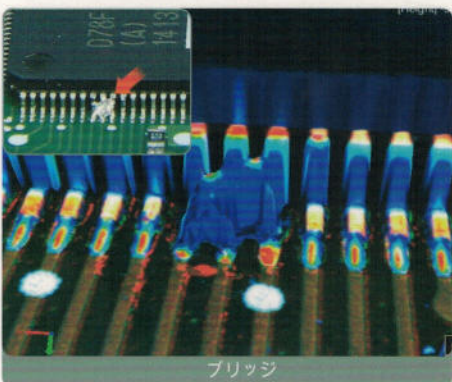
極性間違い



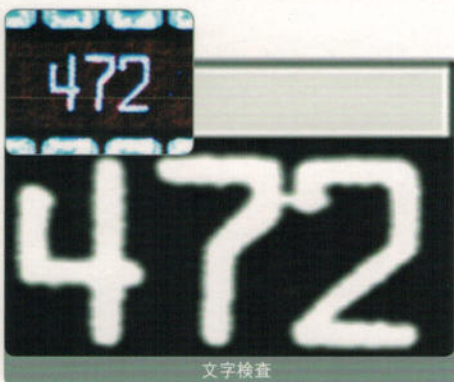
極性間違い



はんだ不良(コールドジョイント)



ブリッジ



文字検査

Xceedシリーズ仕様



機種	Xceed	Xceed L	Xceed XL	Xceed D
センサーヘッド (TRSC-I 3D Sensor Camera)				
測定原理	デュアルレーザー光学三角測量			
カメラシステム	ピクセル			
照明	RGB LED 3段照明			
スキャンスピード(sq.cm/sec)	65 sq.cm/sec			
* X-Y分解能(μm)	14 x 14μm			
ビーム幅(mm)	32mm			
高さ分解能(μm)	0.4μm			
精度				
繰り返し高さ	3 Sigma < 3 μm / 高さ			
高さ精度	5μm 以内			
測定				
測定内容	寸法、未実装、位置ずれ(X/Y/回転)、誤実装(ポディー)、部品立ち(マンハッタン)、文字(OCV/OCR)、誤実装(マッチング)、コールドジョイント、リード変形、リード欠落、リード位置ずれ、ブリッジ、カラーバンド、ピン、共平面性			
基板反り	±5mm (2%)			
バーコード	TRSC-Iによる1D/2Dバーコード検査			
最大部品高さ	40mm			
対象基板仕様				
最小基板サイズ(mm)	50 x 50			
* 最大基板サイズ(mm)	410 x 350	510 x 510	810 x 610	410 x 320
基板厚み	0.4 ~ 5	0.4 ~ 5	0.4 ~ 10	0.4 ~ 5
最大基板重量(kg)	2 kg	4 kg	6 kg	2 kg
上面/下面 基板みみ(mm / mm)	2.5 / 4.0	2.5 / 4.0	2.5 / 4.0	2.5 / 4.0
基板上面/下面クリアランス	50 / 50	50 / 50	50 / 50	40 / 30
装置				
* 装置寸法 (W x D x H)	850 x 1,205 x 1,525	950 x 1,365 x 1,525	1,310 x 1,540 x 1,525	850 x 1,580 x 1,510
装置重量(kg)	750 kg	900 kg	1,100 kg	950 kg
搬送高さ(mm)	860 ~ 970			
搬送スピード	300 ~ 1000 mm/sec			
基板流れ方向	左>右もしくは左>右(工場出荷時に指定)			
基板幅調整	自動			
コンピュータ及び制御機器				
CPU	7-5820K			
オペレーションシステム	MS-Windows 7 64 bit			
モニタ	23" LED			
入力	マウス、キーボード			
外装	CE規定遵守			
電源・エア	AC 220V, 5 Kgf/sq.cm			
ソフトウェアシステム				
検査プログラム	AOIworks			
オフライン・ティーチング	AOIworks for Offline			
統計的工程分析&工程モニタリング	SPCworks for AOI			
不良分析	Verifier			
システム診断	AOI Manager			
ティーチング	ePM-SPI			

※ 本カタログに収録された資源と製品使用は品質工場のため予告無しに変更されることがあります。



PARMI CO., LTD

- Daeduk Atomic Valley 32-18, Yuseong-daero 1596 Beon-gil, Yuseong-gu, Daejeon, 305811, Korea
- TEL : 82-42-478-9900 FAX : 82-42-478-9905

PARMI SUWON OFFICE

- 23, Saneop-ro 156beon-gil, Gwonseon-gu,, Suwon-si, Gyeonggi-do, 441360, Korea
- TEL: 82-31-8019-9910 FAX: 82-31-8019-9905

株式会社PARMI日本支店

- 102-0074 東京都千代田区九段南3-3-3ヨコヤマビル1階
- TEL : 03-6261-4660

www.parmi.com

PARMI CHINA (DONGGUAN)

- 9-122 Xinyi No1 cuiyi Rd Changan town, Dongguan City, Guangdong province, CHINA(523000)
- TEL : +86-769-8150-1199

PARMI AMERICA(BOSTON)

- 362 Elm Street Unit 9 Marlboro, Ma 01752, USA
- TEL : +1-508-485-8120

PARMI EUROPE GmbH (GERMANY)

- Lohstr. 28 D-85445 Oberding, Schwaig, GERMANY
- TEL : +49-8122-88071- 0